

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成22年10月14日 (2010.10.14)

【公開番号】特開2008-198974(P2008-198974A)

【公開日】平成20年8月28日 (2008.8.28)

【年通号数】公開・登録公報2008-034

【出願番号】特願2007-226126(P2007-226126)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/304 (2006.01)

H 0 1 L 21/306 (2006.01)

H 0 1 L 21/027 (2006.01)

G 0 2 F 1/1333 (2006.01)

G 0 2 F 1/13 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/304 6 4 3 C

H 0 1 L 21/304 6 4 3 D

H 0 1 L 21/304 6 4 2 E

H 0 1 L 21/304 6 4 2 F

H 0 1 L 21/306 B

H 0 1 L 21/30 5 7 2 B

G 0 2 F 1/1333 5 0 0

G 0 2 F 1/13 1 0 1

【手続補正書】

【提出日】平成22年8月30日 (2010.8.30)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基板を処理液によって処理する処理装置であって、

ナノバブルを発生させ、そのナノバブルを上記処理液に混合させるナノバブル発生手段を備え、

上記ナノバブル発生手段は、

内部に剪断室が形成された気体剪断器と、

上記気体剪断器の軸方向の一端部に設けられ上記気体を上記剪断室に旋回させて供給する気体供給部と、

上記気体剪断器の一端部の外周面に設けられ上記処理液を上記剪断室に旋回させて供給し、上記気体との旋回速度の差によって上記気体から上記ナノバブルを発生させる液体供給部と

によって構成されていることを特徴とする基板の処理装置。